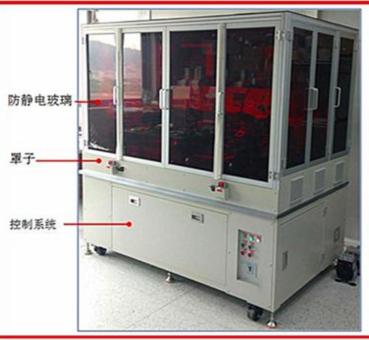
25G全预置焊锡一体式共晶设备

外观和主要功能获专利保护



创新点:

技术一:芯片拾取焊接系统

技术二;高精度芯片快速定位装置

技术三;蓝膜分离取晶装置

技术四;视觉定位共晶焊接装置

技术指示:

直线电机; X、Y、重复精度1um、R1° 焊接吸嘴; 20g---80g压力传感监控

共晶焊台; 常温—400度、曲线控制焊接

UPH 值; 200 / PCS

品质精度; ≤+-5µM,角度+-1° 主件移动; 光标定位\线性电机 芯片定位; 重心检测 \ 图像识别 运行软件; 模块化控制 / 惯量定位

知识产权;发明3项、外观1项、实用新型15项、

软件著作权1项



底座、上锡 热沉、管脚

上锡、芯片



25G底座



热沉





芯片焊接

创新点:

技术一;芯片拾取焊接系统

技术二:高精度芯片快速定位装置

技术三; 蓝膜分离取晶装置

技术四;视觉定位共晶焊接装置

技术指示:

直线电机; X、Y、重复精度1um、R1°

焊接吸嘴; 20q---80g压力传感监控

共晶焊台; 常温—400度、曲线控制焊接

UPH 值; 200 / PCS

品质精度; ≤+-5µM ,角度+-1°

主件移动; 光标定位\线性电机

芯片定位; 重心检测 \ 图像识别

运行软件; 模块化控制 / 惯量定位

知识产权; 发明3项、外观1项、实用新型15项、

软件著作权1项